

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年1月15日(2009.1.15)

【公開番号】特開2008-235842(P2008-235842A)

【公開日】平成20年10月2日(2008.10.2)

【年通号数】公開・登録公報2008-039

【出願番号】特願2007-107585(P2007-107585)

【国際特許分類】

H 01 L 23/36 (2006.01)

【F I】

H 01 L 23/36 Z

【手続補正書】

【提出日】平成20年9月5日(2008.9.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】手続補正書

【補正対象項目名】手続補正1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

2つ以上のフィンを一方の面に、半導体を取り付ける面を、もう一方の面に備えたベース片に形成された突状部を他の接続するベース片に設けた対応する凹状部に圧力により次々に接続することによりベース面と複数のフィンを構成することを特徴とし、前記フィンは、前記ベース片に形成された、フィン間ピッチを4mm以下にするための角度を備えた溝に、かしめられること特徴とするヒートシンク。

【請求項2】

フィンを一方の面に、半導体を取り付ける面を、もう一方の面に備えたベース片に形成された突状部を他の接続するベース片に設けた対応する凹状部に圧力により次々に接続することによりベース面と複数のフィンを構成することを特徴とし、前記フィンは、前記ベース片に形成された、フィン間ピッチを小さくするための角度を備えた溝に、かしめられること特徴とするヒートシンク。

【請求項3】

かしめによって接続されるフィンを一方の面に、半導体を取り付ける面を、もう一方の面に備えたベース片に形成された突状部を他の接続するベース片に設けた対応する凹状部に圧力により次々に接続することによりベース面とフィン間ピッチが4mm以下の複数のフィンを構成することを特徴とするヒートシンク。

【請求項4】

ベース面からの熱を放熱するフィンを一方の面に、半導体を取り付ける面を、もう一方の面に備えた2つのベース片を、接続部を介し左右に構成されたヒートシンク片に形成された突状部を他の接続するヒートシンク片に設けた対応する凹状部に圧力により次々に接続し接続後前記接続部を切断することによりベース面と複数のフィンを構成することを特徴とするヒートシンクの製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】手続補正書

【補正対象項目名】手続補正 2

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 3】

【補正対象書類名】手続補正書

【補正対象項目名】手続補正 3

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 4】

【補正対象書類名】手続補正書

【補正対象項目名】手続補正 4

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 5】

【補正対象書類名】手続補正書

【補正対象項目名】手続補正 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【手続補正 6】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図3】

